

平成19年9月期 決算説明会



Automobile Industry



Electronics Industry

Nov. 13, 2007

1/35



平成19年9月期
業績結果について



2/35

<連結>



平成19年9月期決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

	19/9期	18/9期	増減額	増減率
売上高	45,219	39,748	+5,470	+13.8%
売上総利益	12,755	12,119	+635	+5.2%
売上総利益率	28.2%	30.5%		△2.3P
販管費	7,211	7,276	△65	△0.9%
販管費率	15.9%	18.3%		△2.4P
営業利益	5,544	4,842	+701	+14.5%
営業利益率	12.3%	12.2%		+0.1P
経常利益	5,853	5,202	+650	+12.5%
経常利益率	12.9%	13.1%		△0.2P
当期純利益	3,553	3,633	△79	△2.2%
当期純利益率	7.9%	9.2%		△1.3P

■売上高の増加

<事業別>

抵抗溶接
中国・タイなど、アジア地域の売上が増加

平面研磨
シリコンウェーハや先端素材各社への売上が大幅に増加

■営業・経常利益の増加

<事業別>

抵抗溶接
原材料価格高騰により利益減少

平面研磨
売上増加に伴い収益拡大



3/35

<連結>



平成19年9月期決算概要-②

連結損益計算書

■セグメント別損益

(単位 百万円)

	抵抗溶接	増減	レーザー	増減	平面研磨	増減	合計	増減
売上高	19,890	+856	356	△117	24,972	+4,735	45,219	+5,470
売上総利益	4,977	△564	74	△58	7,704	+1,322	12,755	+635
売上総利益率	25.0%	△4.1P	20.8%	△7.1P	30.9%	△0.7P	28.2%	△2.3P
販管費	3,641	△32	141	+12	3,428	+17	7,211	△65
販管費率	18.3%	△1.0P	39.7%	+12.4P	13.7%	△3.2P	15.9%	△2.4P
営業利益	1,335	△532	△67	△70	4,275	+1,304	5,544	+701
営業利益率	6.7%	△3.8P	△18.9%	△19.5P	17.1%	+2.4P	12.3%	+0.1P



* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

4/35

<連結>



平成19年9月期決算概要-③

連結損益計算書

■販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

	19/9期		18/9期		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	3,600	8.0%	3,713	9.3%	△112
減価償却費	439	1.0%	484	1.2%	△44
運送費	700	1.5%	594	1.5%	+105
旅費交通費	511	1.1%	433	1.1%	+78
研究開発費	277	0.6%	320	0.8%	△42
その他	1,681	3.7%	1,731	4.4%	△50
合計	7,211	15.9%	7,276	18.3%	△65



期末従業員数	1,572人	1,543人	29人増
--------	--------	--------	------

5/35

<連結>



平成19年9月期決算概要-④

連結貸借対照表

(単位 百万円)

資産	19/9期		18/9期		増減	負債純資産	19/9期		18/9期		増減
	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	33,347	72.9%	24,972	67.2%	+8,375	流動負債	20,407	44.7%	13,669	36.8%	+6,738
有形固定資産	9,465	20.7%	8,941	24.1%	+524	固定負債	970	2.1%	1,992	5.3%	△1,022
無形固定資産	256	0.6%	226	0.6%	+29	(有利子負債)	(6,728)	(14.7%)	(4,334)	(11.7%)	(2,393)
投資等	2,646	5.8%	3,025	8.1%	△379	純資産	24,337	53.2%	21,503	57.9%	+2,834
合計	45,716	100.0%	37,166	100.0%	+8,550	合計	45,716	100.0%	37,166	100.0%	+8,550

<主な増減>

売掛債権	→	3,777百万円増 (19/9期)	14,977百万円 (18/9期)	11,200百万円
たな卸資産	→	1,902百万円増 (19/9期)	9,069百万円 (18/9期)	7,167百万円
未収入金	→	1,205百万円増 (19/9期)	2,664百万円 (18/9期)	1,459百万円
買掛債務	→	1,389百万円増 (19/9期)	7,810百万円 (18/9期)	6,420百万円



売上及び受注が増加したことにより、売掛債権、たな卸資産、未収入金及び買掛債務、有利子負債が増加

6/35

平成20年9月期の予想と グループの展望

<連結>

連結会社の系統図



OBARA株式会社



抵抗溶接

レーザー溶接

平面研磨装置

スピードファム株式会社

OBARA CORP. USA
 小原（南京）機電有限公司
 小原（上海）有限公司
 韓国小原株式会社
 OBARA (THAILAND) CO., LTD.
 OBARA (MALAYSIA) SDN. BHD.
 洋光産業株式会社
 OBARA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.
 OBARA AUSTRALIA PTY. LTD.
 OBARA INDIA PRIVATE LTD.

佐久精機株式会社
 SPEEDFAM INC. (台湾)
 SPEEDFAM (INDIA) PVT LTD.
 SPEEDFAM MECHTRONICS (上海)
 SPEEDFAM CORPORATION (USA)
 SpeedFam (BVI) LTD.
 S/Fクリーンシステム株式会社
 SpeedFam NV/SA (ベルギー)
 SPEEDFAM KOREA LTD.

<連結>



平成20年9月期業績予想（通期連結）

（単位 百万円）

	20/9期予想	19/9期実績	増減額	増減率
売上高	47,000	45,219	+1,780	+3.9%
売上総利益	13,600	12,755	+844	+6.6%
売上総利益率	28.9%	28.2%		+0.7P
販管費	7,700	7,211	+488	+6.8%
販管費率	16.4%	15.9%		+0.5P
営業利益	5,900	5,544	+355	+6.4%
営業利益率	12.6%	12.3%		+0.3P
経常利益	6,100	5,853	+246	+4.2%
経常利益率	13.0%	12.9%		+0.1P
当期純利益	3,850	3,553	+296	+8.3%
当期純利益率	8.2%	7.9%		+0.3P



9/35

<連結>



平成20年9月期予想（上・下半期）

（単位 百万円）

	20/9期 上半期予想	前同期比	20/9期 下半期予想	前同期比
売上高	23,000	+2,019	24,000	△239
売上総利益	6,740	+906	6,860	△62
売上総利益率	29.3%	+1.5P	28.6%	+0.0P
販管費	3,940	+575	3,760	△86
販管費率	17.1%	+1.1P	15.7%	△0.2P
営業利益	2,800	+331	3,100	+24
営業利益率	12.2%	+0.4P	12.9%	+0.2P
経常利益	2,900	+231	3,200	+15
経常利益率	12.6%	△0.1P	13.3%	+0.2P
当期純利益	1,800	+133	2,050	+162
当期純利益率	7.8%	△0.1P	8.5%	+0.8P



10/35

<連結>



平成20年9月期業績予想（セグメント別）

（単位 百万円）

	抵抗溶接	前同期比	レーザー	前同期比	平面研磨	前同期比	合計	前同期比
売上高	20,000	+109	500	+143	26,500	+1,527	47,000	+1,780
売上総利益	5,350	+372	140	+65	8,110	+405	13,600	+844
売上総利益率	26.8%	+1.7P	28.0%	+7.2P	30.6%	△0.2P	28.9%	+0.7P
販管費	3,750	+108	130	△11	3,820	+396	7,700	+488
販管費率	18.8%	+0.4P	26.0%	△13.7P	14.4%	+0.7P	16.4%	+0.4P
営業利益	1,600	+264	10	+77	4,290	+9	5,900	+355
営業利益率	8.0%	+1.3P	2.0%	+20.6P	16.2%	△1.0P	12.6%	+0.3P



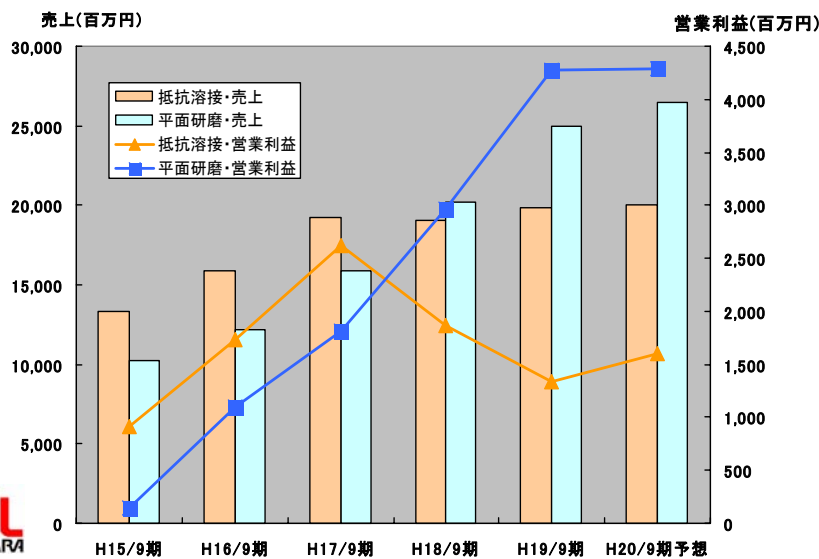
* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

11/35

<連結>



セグメント別業績の推移



12/35

<連結>



主な項目の実績と予想

(平成19年9月期実績)

(平成20年9月期予想)

◆ 設備投資		
1,628百万円	→	2,280百万円
◆ 減価償却費		
1,122百万円	→	1,200百万円
◆ 研究開発費		
562百万円	→	600百万円
◆ 銅価格		
90万円/ton	→	96万円/ton
◆ 為替想定レート		

\$=110円(1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)

注) 設備投資は有形無形を含む



13/35

<抵抗溶接>

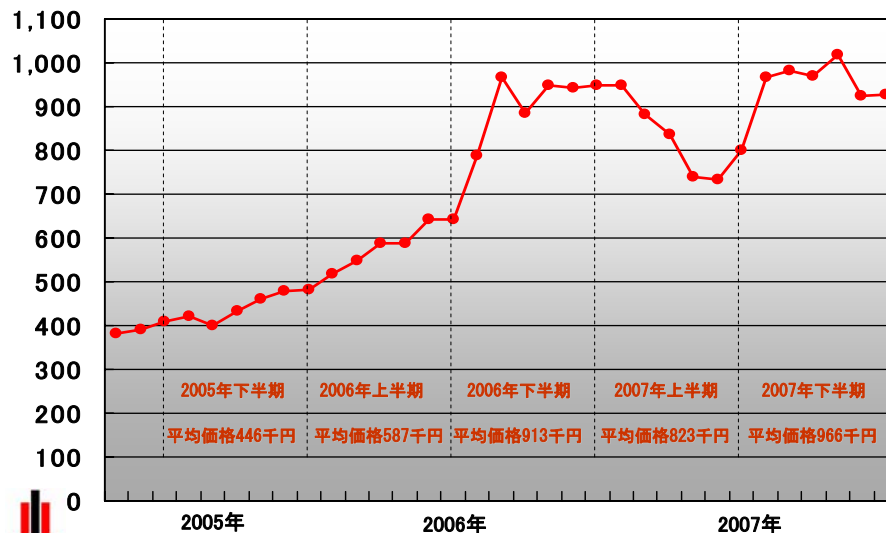


14/35

<抵抗溶接>

主要原材料、銅の値動き

(千円/t)



15/35

<抵抗溶接>

抵抗溶接事業 平成20年9月期業績予想

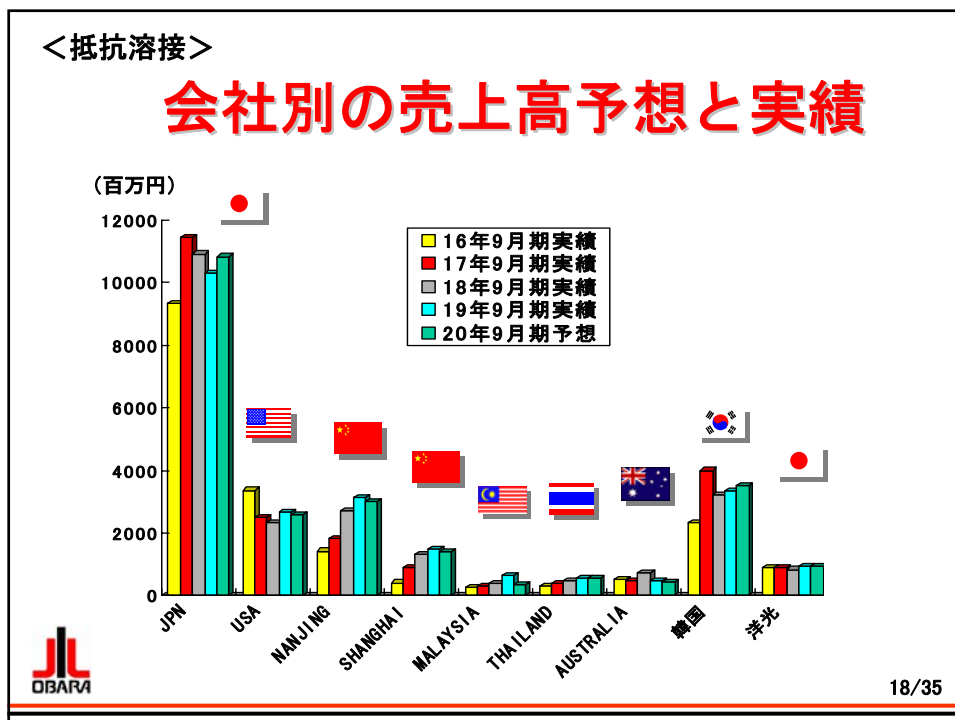
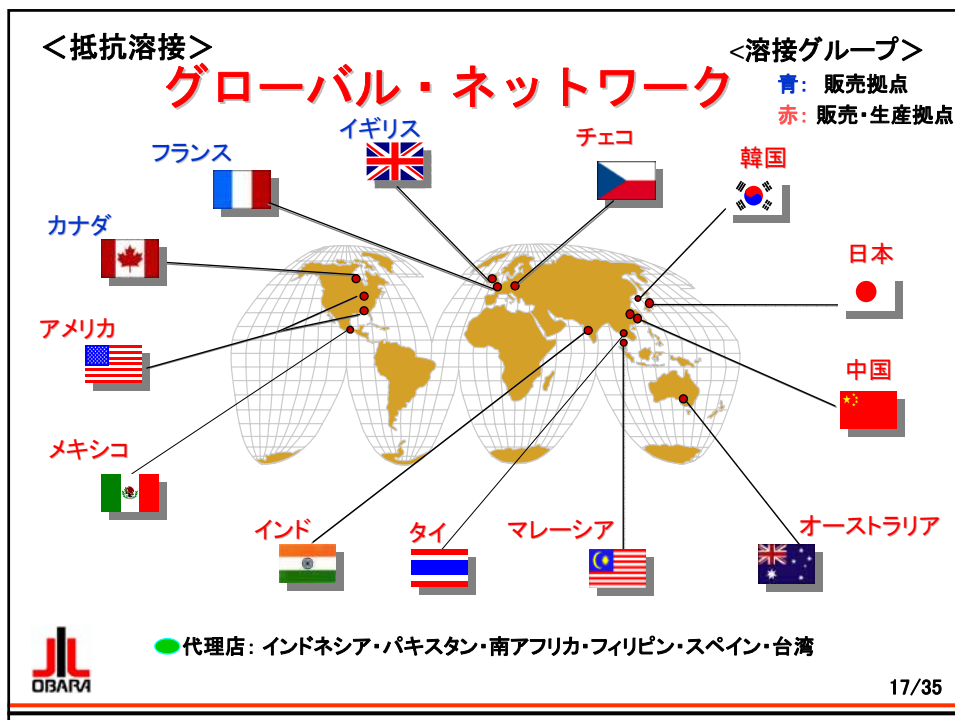
(単位 百万円)

	20/9期 上半期予想	前同期比	20/9期 下半期予想	前同期比	20/9期 通期予想	前同期比
売上高	10,250	+269	9,750	△160	20,000	+109
売上総利益	2,770	+133	2,580	+239	5,350	+372
売上総利益率	27.0%	+0.6P	26.5%	+2.8P	26.8%	+1.7P
販管費	1,910	+219	1,840	△110	3,750	+108
販管費率	18.6%	+1.7P	18.9%	△0.8P	18.8%	+0.4P
営業利益	860	△85	740	+349	1,600	+264
営業利益率	8.4%	△1.1P	7.6%	+3.7P	8.0%	+1.3P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

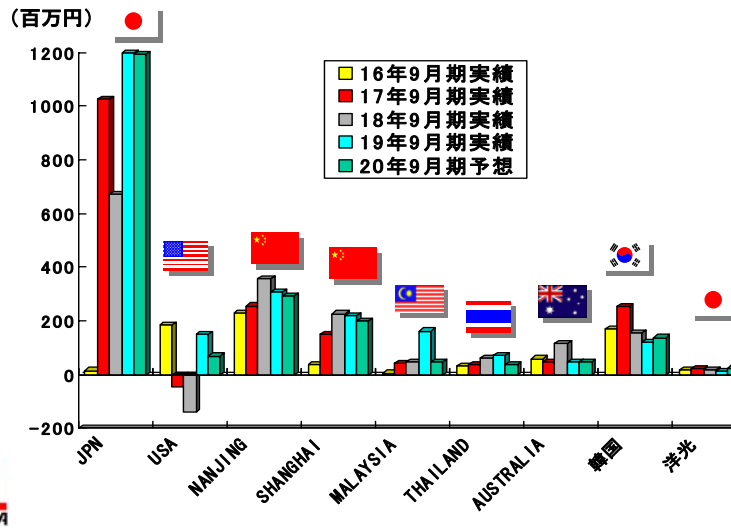


16/35



<抵抗溶接>

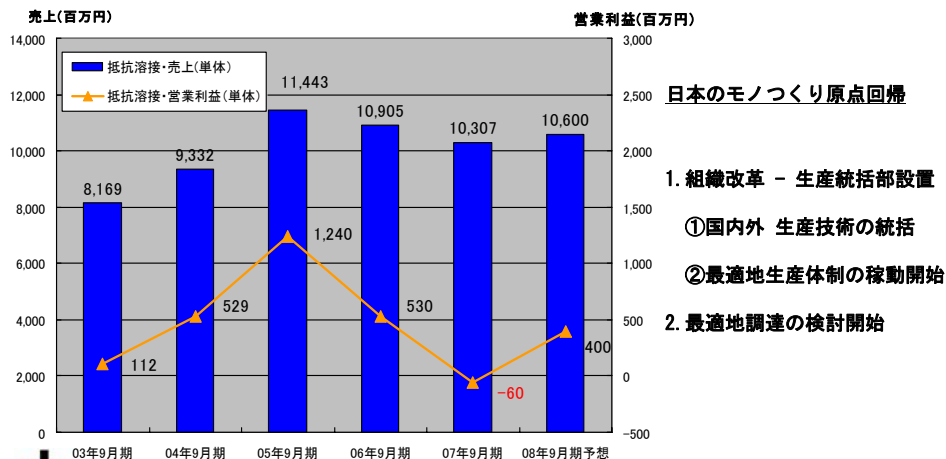
会社別の当期純利益実績と予想



<抵抗溶接>

Topics-①

日本(単体)の収益力改善に向けた抜本的改革



日本のモノづくり原点回帰

1. 組織改革 - 生産統括部設置

①国内外 生産技術の統括

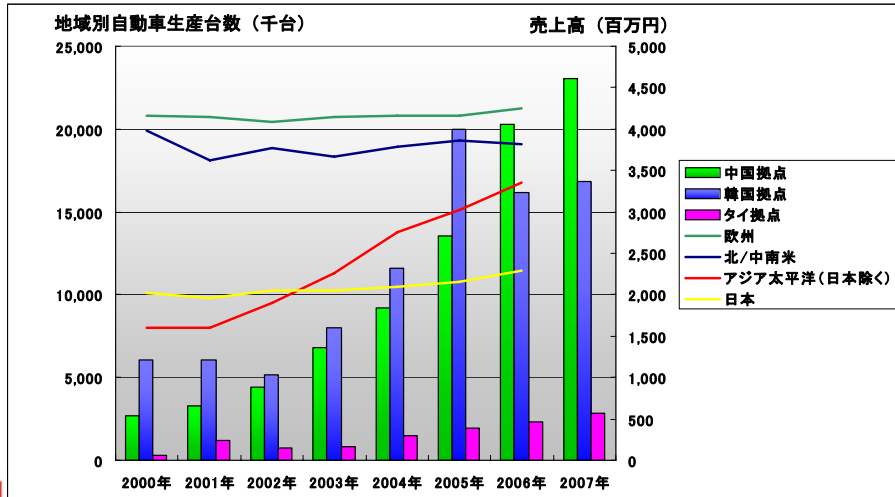
②最適地生産体制の稼働開始

2. 最適地調達の検討開始



Asian Market 重視と強化

— 地域別自動車生産台数と主なアジア拠点別 売上推移 —



タイの現地法人、新工場建設開始



既存工場

目的

・ 拡大する日系・欧米自動車メーカー様のサポート

特徴

・ 技術人員を大幅に増員し、サポート体制強化

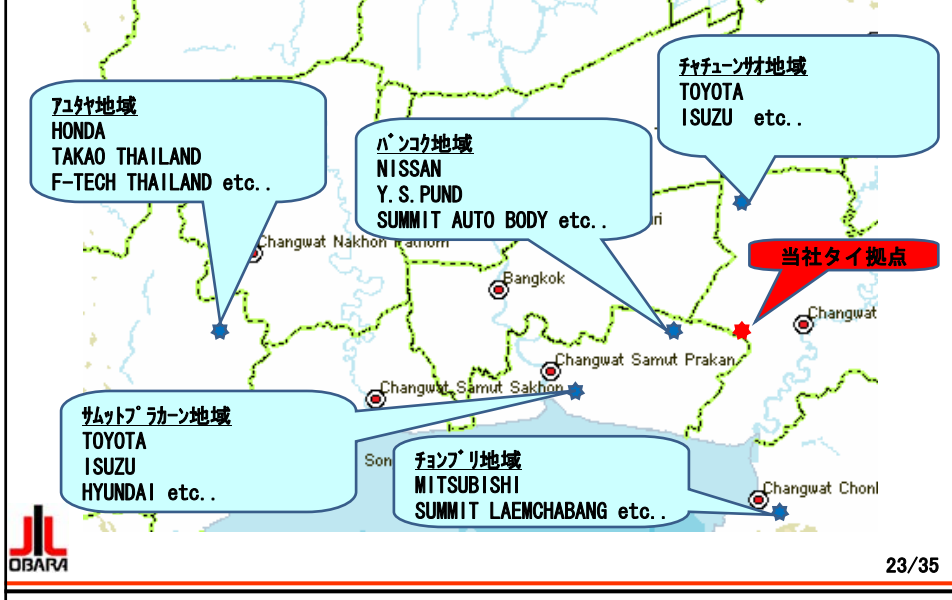
工場の概要

土地 5,250 m² (現状の3.5倍)

建物 2,400 m² (現状の2倍)



自動車メーカー様の製造拠点とタイ拠点の位置関係



韓国の現地法人、新工場建設開始



目的

- ・韓国系メーカー様の国内外案件をトータルサポート
- ・アジア生産拠点の分散（リスク低減）

工場の概要

- ・土地 12,850 m² (現状の2倍)
- ・建物 15,420 m² (現状の3倍)



<抵抗溶接>

Topics (韓国資料)

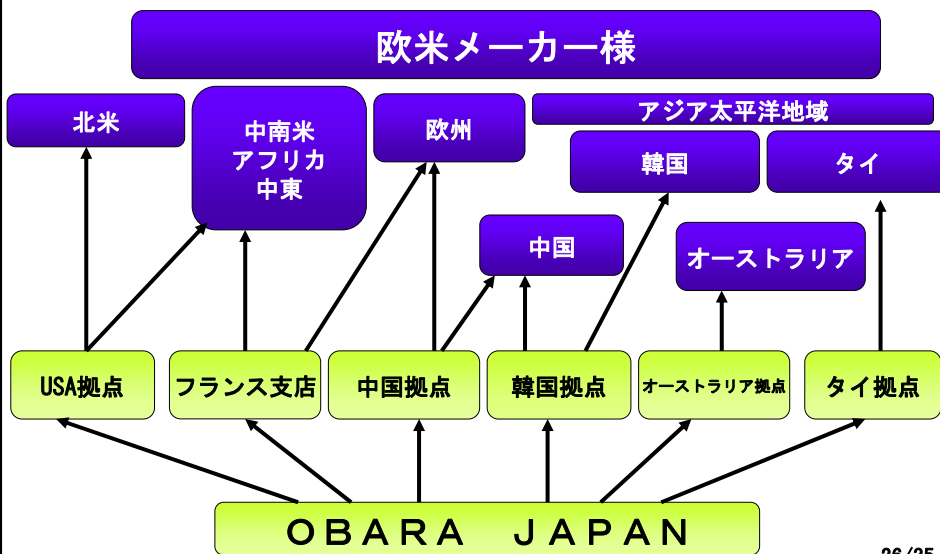


25/35

<抵抗溶接>

Topics-③

欧米メーカー様へのNetWork深化



26/35



平面研磨事業の概況



平面研磨事業の概況

エレクトロニクス製品市場の好調が持続

- ▶ シリコンウェーハ各社の設備増強が継続し、高精度研磨装置を積極販売
- ▶ ハードディスクドライブ市場においても、装置販売が伸長

平面研磨事業 20年9月期業績予想

(単位 百万円)

	20/9期 上半期予想	前同期比	20/9期 下半期予想	前同期比	20/9期 通期予想	前同期比
売上高	12,500	+1,644	14,000	△116	26,500	+1,527
売上総利益	3,900	+720	4,210	△314	8,110	+405
売上総利益率	31.2%	+1.9P	30.1%	△2.0P	30.6%	△0.2P
販管費	1,970	+364	1,850	+26	3,820	+391
販管費率	15.8%	+1.0P	13.2%	+0.3P	14.4%	+0.7P
営業利益	1,930	+355	2,360	△341	4,290	+14
営業利益率	15.4%	+0.9P	16.9%	△2.3P	16.2%	△0.9P

* 上記は参考数値であり、正式な開示数値ではありません

29/35

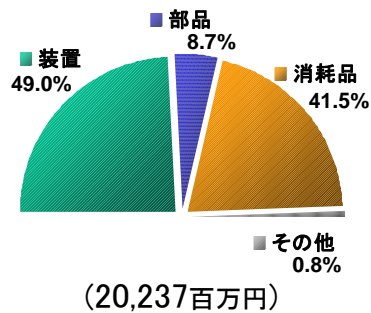
商品群

- ▶ 片面研磨装置、両面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置（エッジポリッシャー）
- ▶ 洗浄装置
- ▶ ドライエッチャー装置（DCP）
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

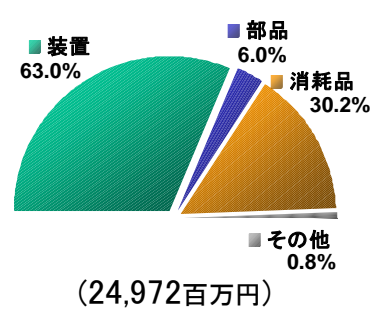
セグメント情報

— 商品別売上構成比 —

18年9月期



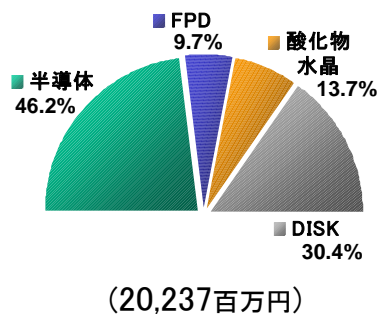
19年9月期



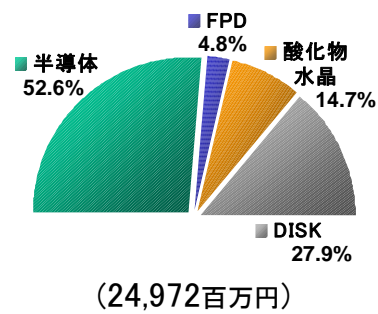
セグメント情報

— アプリケーション別売上構成比 —

18年9月期



19年9月期

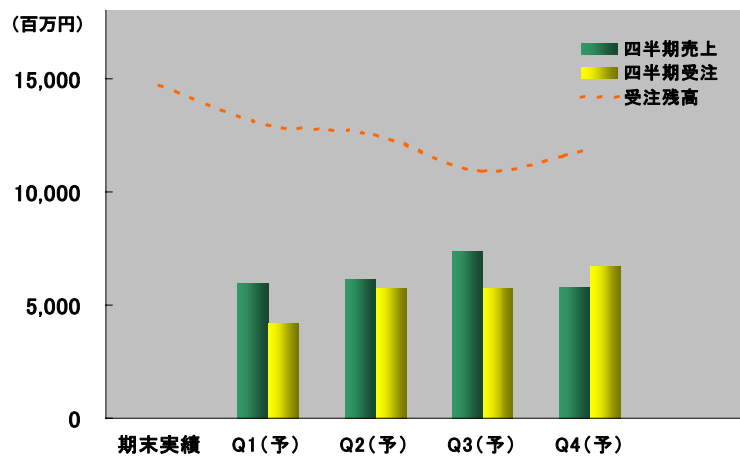




当期の傾注項目の結果

- ▶ 最先端 Si ウェーハ向け両面研磨装置の展開
売上計上51億円と受注残高48億円
- ▶ ハードディスク向け装置の拡販
売上計上34億円と受注残高45億円
- ▶ 半導体デバイス向けエッジポリシャの提案
売上台数 2台と受注残数 2台

受注残高の推移予測



<連結>



OBARAグループのVISION

■ *Niche市場において*
世界一の
企業集団にする



35/35

ご静聴ありがとうございました



<http://www.obara.co.jp>